

導電性接着剤実装と部品接合温湿度加速短時間評価試験の検討

佐々木 喜七^{*}，岡本 秀孝^{**}

**A Study of Device Joint Reliability and Conductive Adhesive Paste Jisso for
Temperature-Humidity Acceleration Short-Time Evaluation Test Methods**

Kishichi SASAKI^{*} and Hidetaka OKAMOTO^{**}

^{*} 元一般財団法人日本電子部品信頼性センター（〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-6 カミナガビル 3 階）

^{**} 一般財団法人日本規格協会（〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル）

^{*} Former Reliability Center for Electronic Components of Japan (Kaminaga Bldg., 2-5-6 Komagata, Taitou-ku, Tokyo 111-0043)

^{**} Japanese Standard Association (Mita Bldg., 3-13-12 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073)